

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 27 年 2 月 26 日 (2015.2.26)

【公開番号】特開 2013-225618 (P2013-225618A)
 【公開日】平成 25 年 10 月 31 日 (2013.10.31)
 【年通号数】公開・登録公報 2013-060
 【出願番号】特願 2012-97793 (P2012-97793)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/66 J

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 1 月 8 日 (2015.1.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体ウェハの欠陥を分類する半導体欠陥分類装置であって、
 表示部と、

前記半導体ウェハ上の検査対象部分を含む検査画像と、複数の製造工程からなる前記半導体ウェハの設計レイアウト情報と、前記設計レイアウト情報が製造工程毎に分割された複数の第 1 のレイアウトデータと、前記第 1 のレイアウトデータに対応する製造工程の誤差情報を含む第 1 の重ね合わせ情報とを格納する記憶部と、

前記検査画像と前記設計レイアウト情報とを前記表示部に表示する演算部と
 を備え、

前記演算部は、少なくとも 1 つの第 1 のレイアウトデータと前記検査画像とを前記記憶部から取得し、前記第 1 の重ね合わせ情報を反映させた前記第 1 のレイアウトデータと前記検査画像とを前記表示部に重ねて表示することを特徴とする半導体欠陥分類装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記第 1 のレイアウトデータに対応する製造工程が、複数の処理工程を含み、

前記記憶部は、前記第 1 のレイアウトデータを処理工程毎に更に分割して、複数の第 2 のレイアウトデータとして格納しており、

前記演算部は、少なくとも 1 つの第 2 のレイアウトデータと前記検査画像とを前記記憶部から取得し、前記第 2 のレイアウトデータと前記検査画像とを前記表示部に重ねて表示することを特徴とする半導体欠陥分類装置。

【請求項 3】

請求項 2 において、

前記記憶部が、前記第 2 のレイアウトデータの重ね合わせに関する第 2 の重ね合わせ情報を格納しており、

前記演算部は、前記第 2 の重ね合わせ情報を反映させた前記第 2 のレイアウトデータと、前記検査画像とを前記表示部に重ねて表示することを特徴とする半導体欠陥分類装置。

【請求項 4】

請求項 3 において、

前記第 2 の重ね合わせ情報は、前記第 2 のレイアウトデータに対応する処理工程によっ

て生成されるパターンの誤差情報と、前記パターンの幅情報との少なくとも１つを含むことを特徴とする半導体欠陥分類装置。

【請求項５】

請求項１において、

ユーザが前記第１のレイアウトデータを選択するための入力部を更に備え、

前記演算部は、前記入力部によって選択された第１のレイアウトデータと前記検査画像とを前記表示部に重ねて表示することを特徴とする半導体欠陥分類装置。

【請求項６】

請求項１において、

前記演算部は、検査対象の前記半導体ウェハの次の製造工程に対応する第１のレイアウトデータを取得し、前記次の工程に対応する第１のレイアウトデータを前記検査画像に更に重ねて表示することを特徴とする半導体欠陥分類装置。

【請求項７】

表示部と記憶部と演算部とを備える情報処理装置に、半導体ウェハの欠陥を分類するための処理を実行させるためのプログラムであって、

前記記憶部は、前記半導体ウェハ上の検査対象部分を含む検査画像と、複数の製造工程からなる前記半導体ウェハの設計レイアウト情報と、前記設計レイアウト情報が製造工程毎に分割された複数の第１のレイアウトデータと、前記第１のレイアウトデータに対応する製造工程の誤差情報を含む第１の重ね合わせ情報とを格納しており、

前記演算部により、少なくとも１つの第１のレイアウトデータと前記検査画像とを前記記憶部から取得する処理と、

前記演算部により、前記第１の重ね合わせ情報を反映させた前記第１のレイアウトデータと前記検査画像とを前記表示部に重ねて表示する処理と
を実行させるためのプログラム。